

北京晶品特装科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司核心技术人员施福明先生的书面辞职报告，施福明先生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后将不再担任公司任何职务。施福明先生与公司签署了相关协议，对其应承担的保密义务和竞业限制义务做出了约定。其与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形。截至本公告披露日，施福明先生所负责的工作已全部交接完毕。

● 公司十分重视研发投入，已建立较为完善的研发管理体系，公司的技术研发与日常经营工作均有序推进。本次核心技术人员的离职不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员施福明先生因个人原因申请辞去所任公司职务，并办理完成离职手续。施福明先生离职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对施福明先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（一）核心技术人员的具体情况

施福明先生，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，自动化专业学士学位。2018年5月至2019年7月任北京华信智航科技有限公司硬件工程师，2019年7月至今任公司研发二部研发主管。

截至本公告披露日，施福明先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东天津军融创富科技中心（有限合伙）7.20%的份额间接持有公司股份。施福明先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利情况

施福明先生在公司任职期间参与研发项目工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与施福明先生签署的相关协议，双方对施福明先生应遵守的保密义务及竞业限制义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现施福明先生存在违反保密或竞业限制义务的情形。

二、 核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系。公司重视研发工作和人才梯队的建设，研发人员结构完善且合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员依赖的情形。2023年末、2024年末和2025年末，公司研发人员的数量分别76人、97人和74人，占员工总数的比例分别为27.44%、26.43%和20.39%。本次核心技术人员调整后不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生重大不利影响的情况。

截至本公告披露日，公司核心技术人员共12人。本次调整前后核心技术人员的的具体情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	陈波、王小兵、王进、吴琳、王景文、陈猛、施福明、叶依顺、陈孙炬、伊春艳、胡正东、张军、秦军红
本次调整后	陈波、王小兵、王进、吴琳、王景文、陈猛、叶依顺、陈孙炬、伊春艳、胡正东、张军、秦军红

三、 公司采取的措施

截至本公告披露日，施福明先生已完成相关工作交接，公司相关核心技术人员工作内容调整已完成，公司各项研发项目正稳步推进。公司高度重视研发团队的建设，在持续加大研发投入力度的同时，不断进行研发体系、研发团队的建设

和完善，通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，持续搭建研发人才梯队，确保公司的研发创新能力。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026年4月28日